

股票代號: 3467



Focus your care~



台灣精材股份有限公司

主辦輔導推薦券商  元大證券
Yuanta Securities

2025年 2月 20日

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

- ❑ 公司概況
- ❑ 市場定位及產品應用
- ❑ 外部環境與核心競爭力
- ❑ 經營實績
- ❑ 半導體市場展望及公司策略布局
- ❑ ESG實績



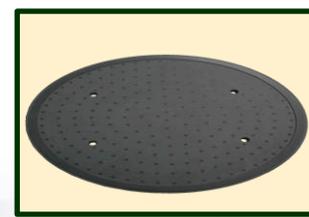
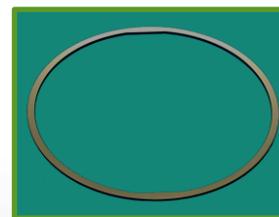
公司概況

台灣精材股份有限公司



- 成立時間: 1997 年
- 製造工廠: 新竹縣湖口鄉
- 資本額: 新台幣 2.8億元
- 董事長: 馬堅勇博士
- 總經理: 王元星
- 員工人數 (1/31/2025): 188人
- 主要產業應用: 半導體

台灣精材年營業額: 新台幣百萬



- 國際設備原廠認證通過，提供半導體級精密陶瓷零件解決方案。具備從精密陶瓷材料製作，到精密加工、表面處理以及最終的零件清洗蝕刻一條龍式的整合核心技術

扎根國際半導體設備大廠

邁向半導體先進製程

建立全球領先競爭力

1990年

- 2004年取得 ISO9001:2000 & 14001:2004證書
- 2005年湖口長安新廠啟用
- 2020年取得ISO 45001:2018證書
- 2009年正式更名為台灣精材股份有限公司

1997年成立啟成實業

2000年



2010年

- 2010年成為國際大型半導體設備製造商的全球合格供應商
- 2013年核心技術通過技術認證:
 - 1) 高純度氧化鋁材料 Sicalox
 - 2) 零組件加工製造技術
 - 3) 零組件清洗技術
- 2014年與國際大廠簽約，進入日本市場的專業代工領域
- 2019年開始供貨高階製程產品



- 2020年更高純度氧化鋁材料 FA998生產線通過國際大廠認證
- 2020年成功開發300mm ceramic domes並開始量產

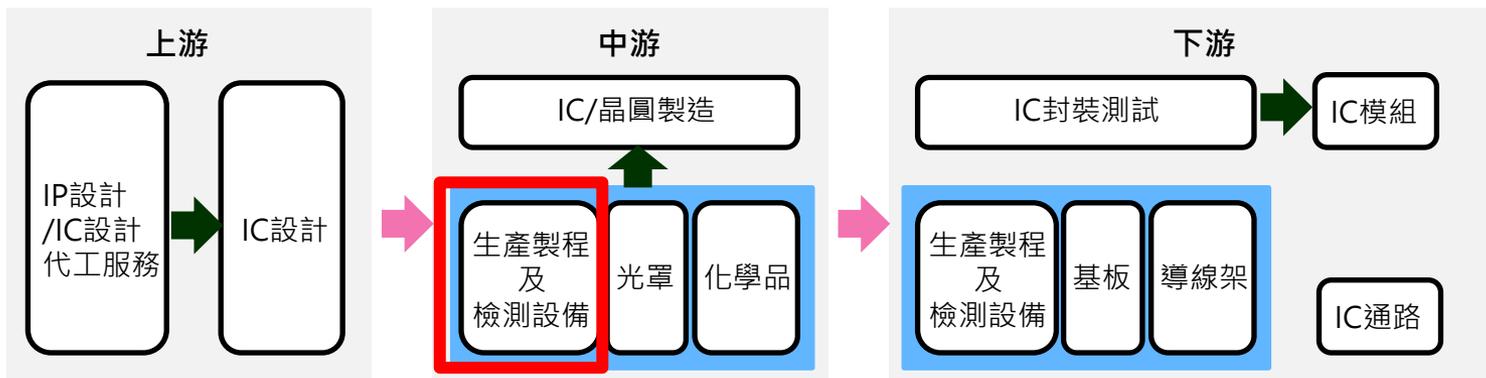
2021~2024年

- 2021年開始與全球領先半導體大廠合作，共同開發先進創新材料與技術
- 2024年創新陶瓷材料開發完成，開始進入高階製程產品測試階段
- 2024年與全球領先半導體設備製造商合作，展開高階零件清洗線建置工作，預計4Q25通過原廠認證
- 2024年12月4日櫃買中心董監聯席會議通過上櫃申請案

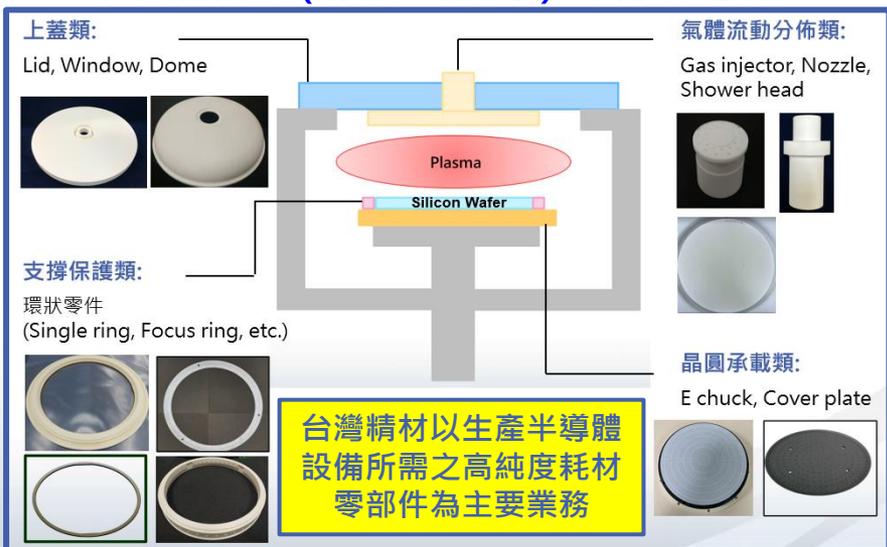


市場定位與產品應用

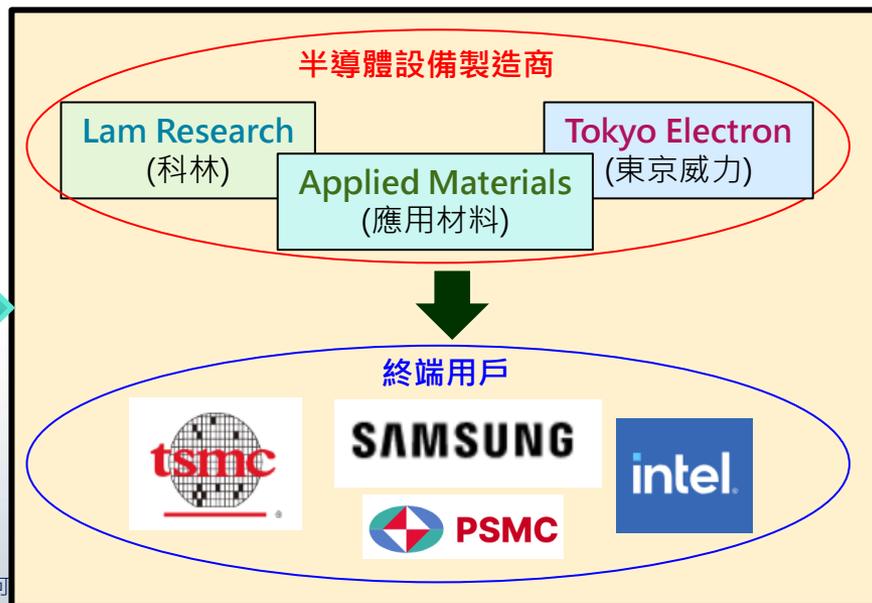
● 半導體價值鏈：



● 半導體設備(薄膜、蝕刻) 零部件應用：



● 半導體設備零組件供應鏈：



文件相關公開資訊須有本資料為台灣精材股份有限公司之專有財產，非經書面許可

This material is the property of the Forcera Materials Co.,LTD.Unauthorized distribution、copy、use or modification is prohibited.

台灣精材的產品是半導體製程的重要「隱形」推手！

- 設備耗材零件的品質直接影響晶圓製造良率
- 台灣精材提供優異的零件材料特性以應對腔室嚴苛環境

✓ 高純度、高密度

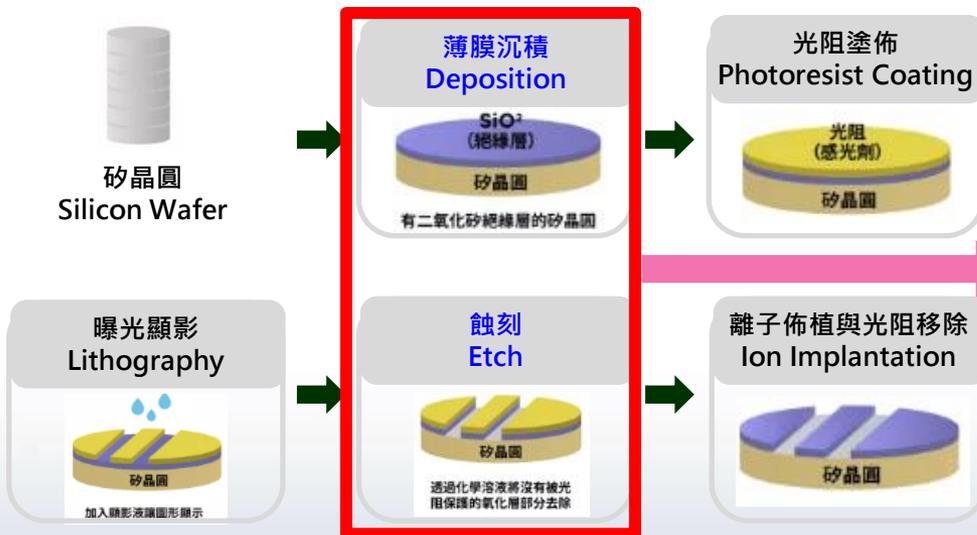
✓ 抗氟電漿腐蝕

✓ 高潔淨度

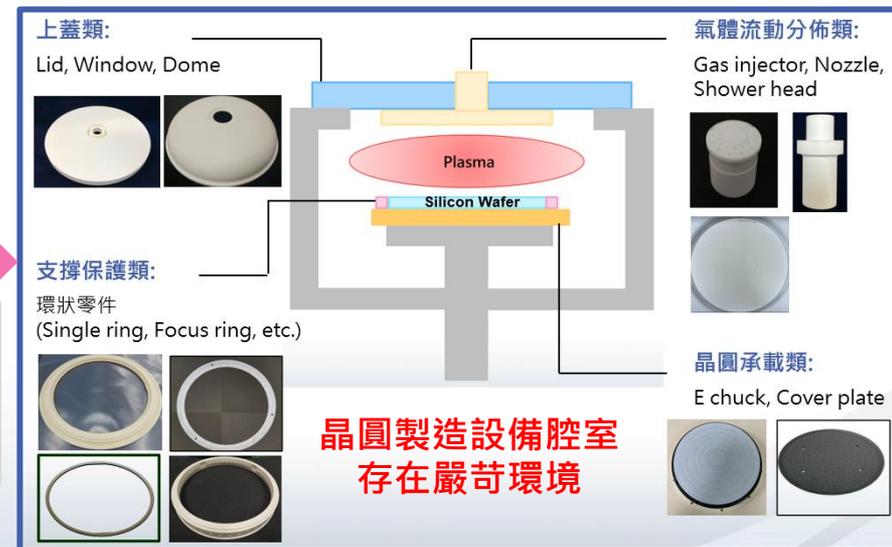


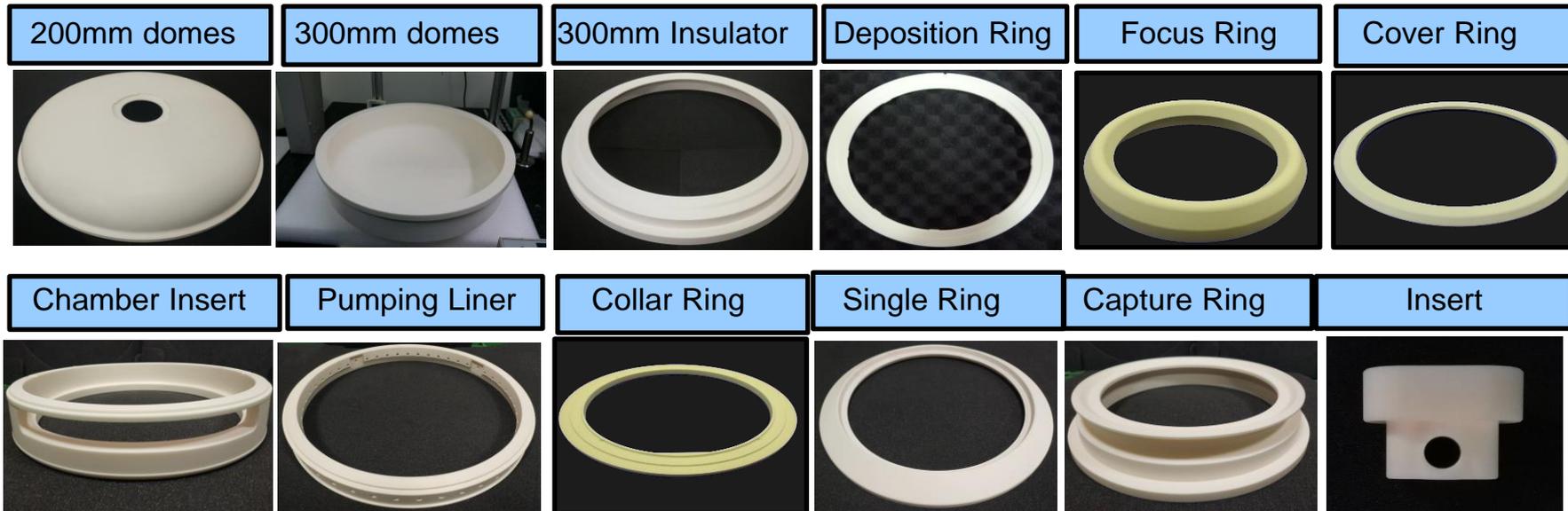
✓ 有效的 particle 控制

● 半導體製造流程:

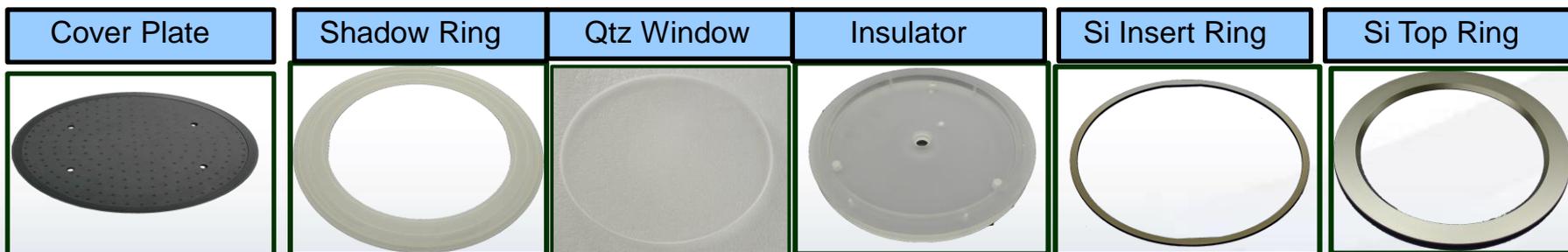


● 半導體設備 (薄膜、蝕刻) 零部件應用::





Alumina (氧化鋁陶瓷)



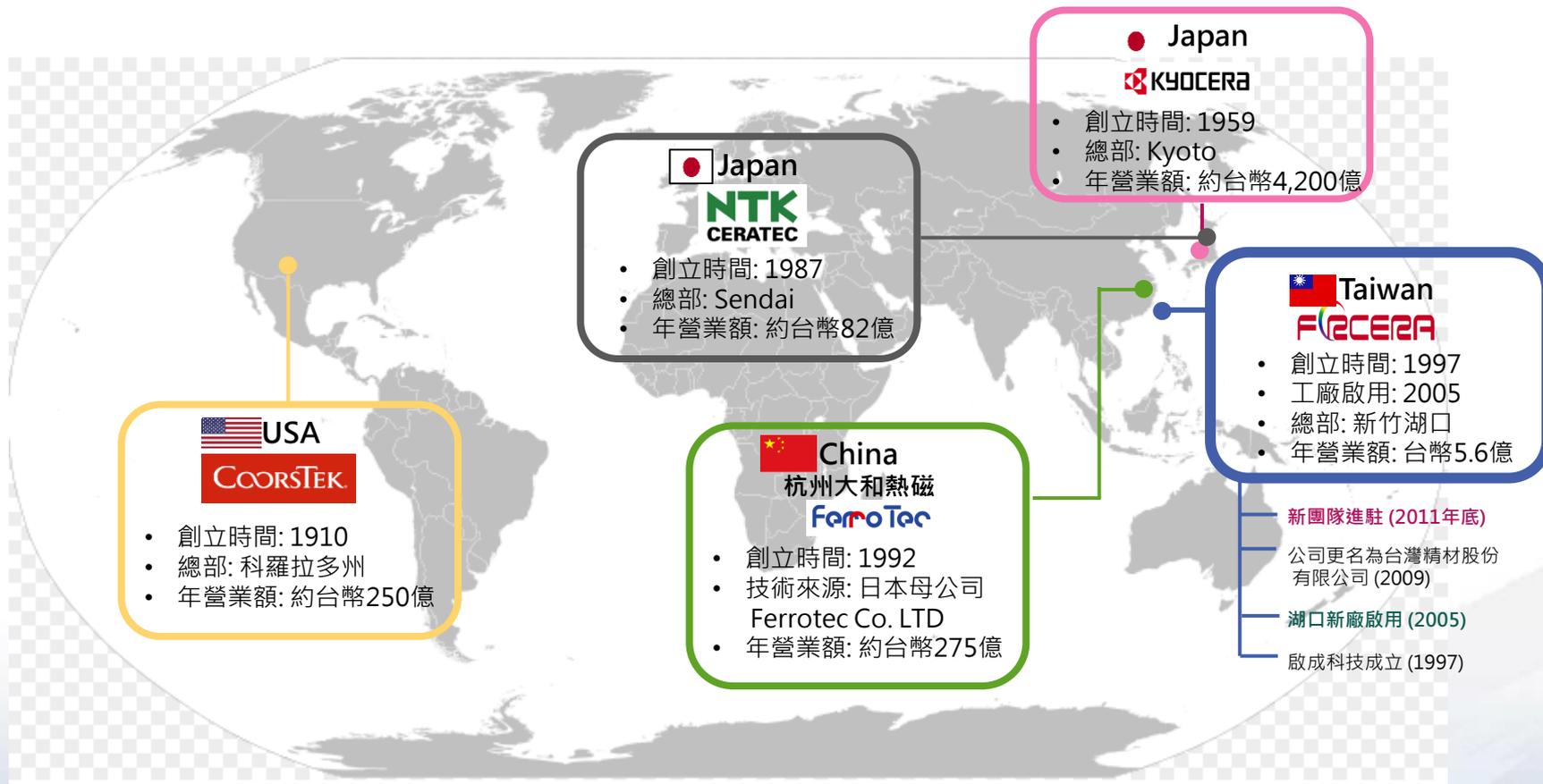
AlN (氮化鋁)

Quartz (石英)

Si Rings (矽環)

外部環境與核心競爭力

- 強大的國外競爭對手，深耕半導體領域多年，具備先進者優勢 (first-mover advantage)
- 台灣精材深耕國際半導體設備大廠，迎頭趕上，計畫在精密陶瓷零件領域建立全球競爭力



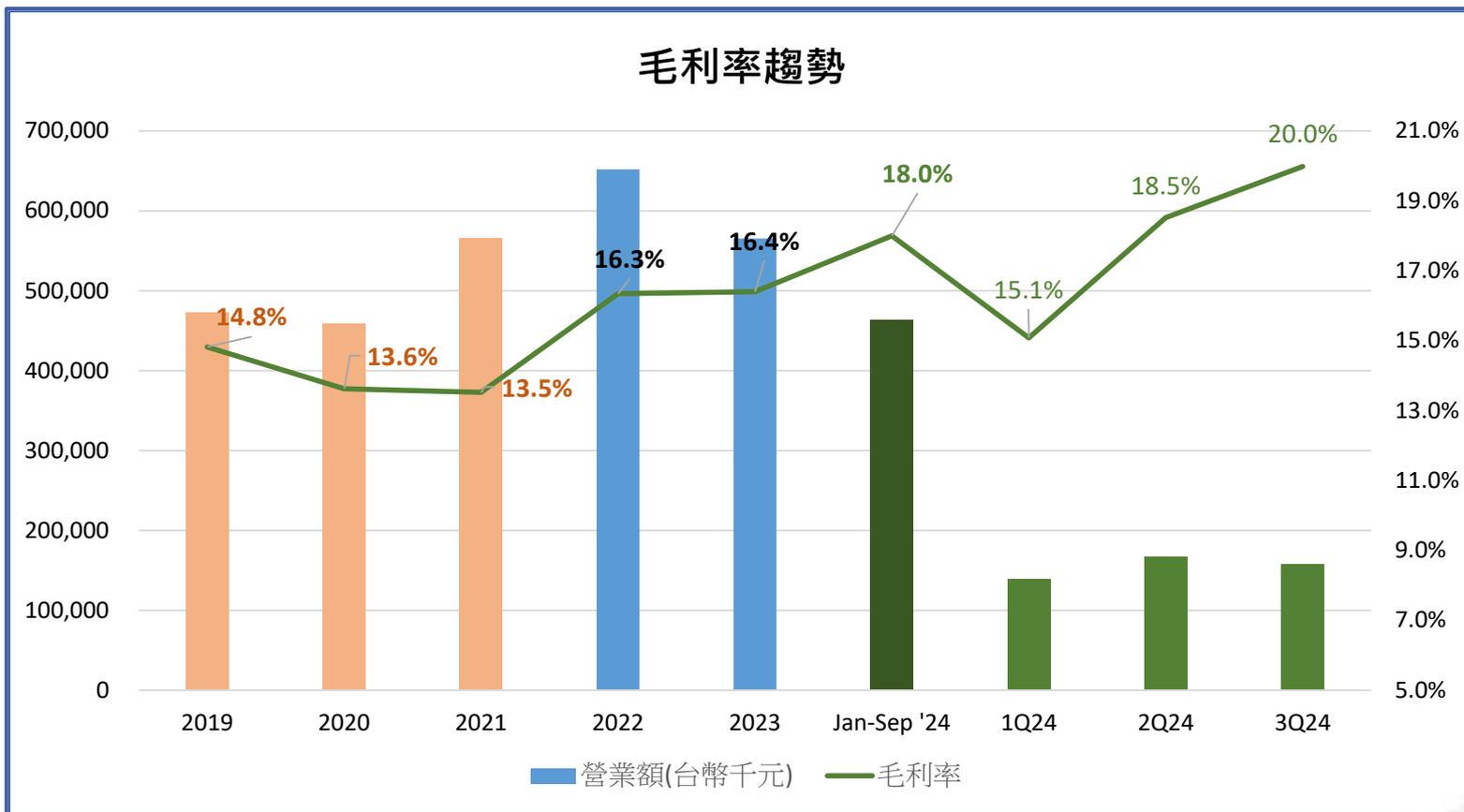
資料來源: 台灣精材依據該公司官網資料彙總

文件相關公開資訊須有本資料為台灣精材股份有限公司之專有財產，非經書面許可，不得對外透露、複印、使用本資料或轉變為其它形式使用字樣。
This material is the property of the Forcera Materials Co.,LTD.Unauthorized distribution、copy、use or modification is prohibited.

經營實績

單位: 新台幣千元	2021		2022		2023		2023 over 2022	2023 over 2021
	Audited	%	Audited	%	Audited	%		
營業收入淨額	564,799	100.0%	651,728	100.0%	563,365	100.0%	-13.6%	-0.3%
銷貨成本	488,440	86.5%	545,217	83.7%	471,248	83.6%	-13.6%	-3.5%
營業毛利	76,359	13.5%	106,511	16.3%	92,117	16.4%	+ 0.1 pts	+ 2.8 pts
營業費用	57,897	10.3%	72,414	11.1%	73,287	13.0%	1.2%	26.6%
營業利益	18,462	3.3%	34,097	5.2%	18,830	3.3%	- 1.9 pts	+ 0.1 pts
營業外損益	(2,630)	-0.5%	8,474	1.3%	3,674	0.7%	-56.6%	-239.7%
稅前淨利	15,832	2.8%	42,571	6.5%	22,504	4.0%	- 2.5 pts	+ 1.2 pts
本期淨利	15,832	2.8%	47,942	7.4%	22,176	3.9%	- 3.4 pts	+ 1.1 pts
基本每股盈餘(元)	0.66		2.01		0.80			

單位: 新台幣千元	2023 1-9月		2024 1-9月		2024 Q1		2024 Q2		2024 Q3		2024 over 2023
	實際達成	%	實際達成	%	實際達成	%	實際達成	%	實際達成	%	
營業收入淨額	434,028	100.0%	463,609	100.0%	139,093	100.0%	166,814	100.0%	157,702	100.0%	6.8%
銷貨成本	361,105	83.2%	380,229	82.0%	118,118	84.9%	135,926	81.5%	126,185	80.0%	5.3%
營業毛利	72,923	16.8%	83,380	18.0%	20,975	15.1%	30,888	18.5%	31,517	20.0%	+1.2 pts
營業費用	54,891	12.6%	63,633	13.7%	19,262	13.8%	21,604	13.0%	22,766	14.4%	15.9%
營業利益	18,032	4.2%	19,747	4.3%	1,713	1.2%	9,284	5.6%	8,751	5.5%	+0.2 pts
營業外損益	3,855	0.9%	2,983	0.6%	2,190	1.6%	1,028	0.6%	(237)	-0.2%	-
稅前淨利	21,887	5.0%	22,730	4.9%	3,904	2.8%	10,312	6.2%	8,514	5.4%	+0.1 pts
本期淨利	19,792	4.6%	20,561	4.4%	3,904	2.8%	8,853	5.3%	7,805	4.9%	-0.4 pts
基本每股盈餘(元)	0.72		0.73		0.14		0.31		0.28		0.01



■ 透過產品組合優化逐年提升毛利率

單位：新台幣千元	Sep 30, 2024		June 30, 2024		December 31, 2023		December 31, 2022		December 31, 2021	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及流動金融資產	136,737	18.8%	163,186	21.9%	115,065	16.4%	103,168	14.5%	88,235	13.1%
應收帳款	79,307	10.9%	82,841	11.1%	64,743	9.2%	78,814	11.1%	87,108	12.9%
存貨	167,458	23.0%	152,211	20.4%	152,882	21.7%	154,768	21.7%	149,710	22.1%
不動產、廠房及設備	305,679	42.0%	314,337	42.1%	341,372	48.5%	348,813	49.0%	331,395	49.0%
資產總計	\$728,396	100.0%	\$746,821	100.0%	\$703,685	100.0%	\$712,393	100.0%	\$675,923	100.0%
應付帳款	113,693	15.6%	153,717	20.6%	97,893	13.9%	163,577	23.0%	152,487	22.6%
流動負債	164,563	22.6%	208,076	27.9%	146,759	20.9%	207,227	29.1%	197,219	29.2%
負債總計	282,679	38.8%	308,909	41.4%	261,605	37.2%	316,573	44.4%	317,493	47.0%
股東權益總計	445,717	61.2%	437,912	58.6%	442,080	62.8%	395,820	55.6%	358,430	53.0%
關鍵財務指標										
負債比	38.8%	41.4%	37.2%	44.4%	47.0%					
流動比	246.9%	201.6%	238.3%	165.8%	170.9%					
速動比	136.7%	121.7%	134.2%	91.1%	95.0%					

半導體市場展望及公司策略布局

SEMI 2024 Year-end Total* Equipment Forecast by Segment (US\$ Billion)



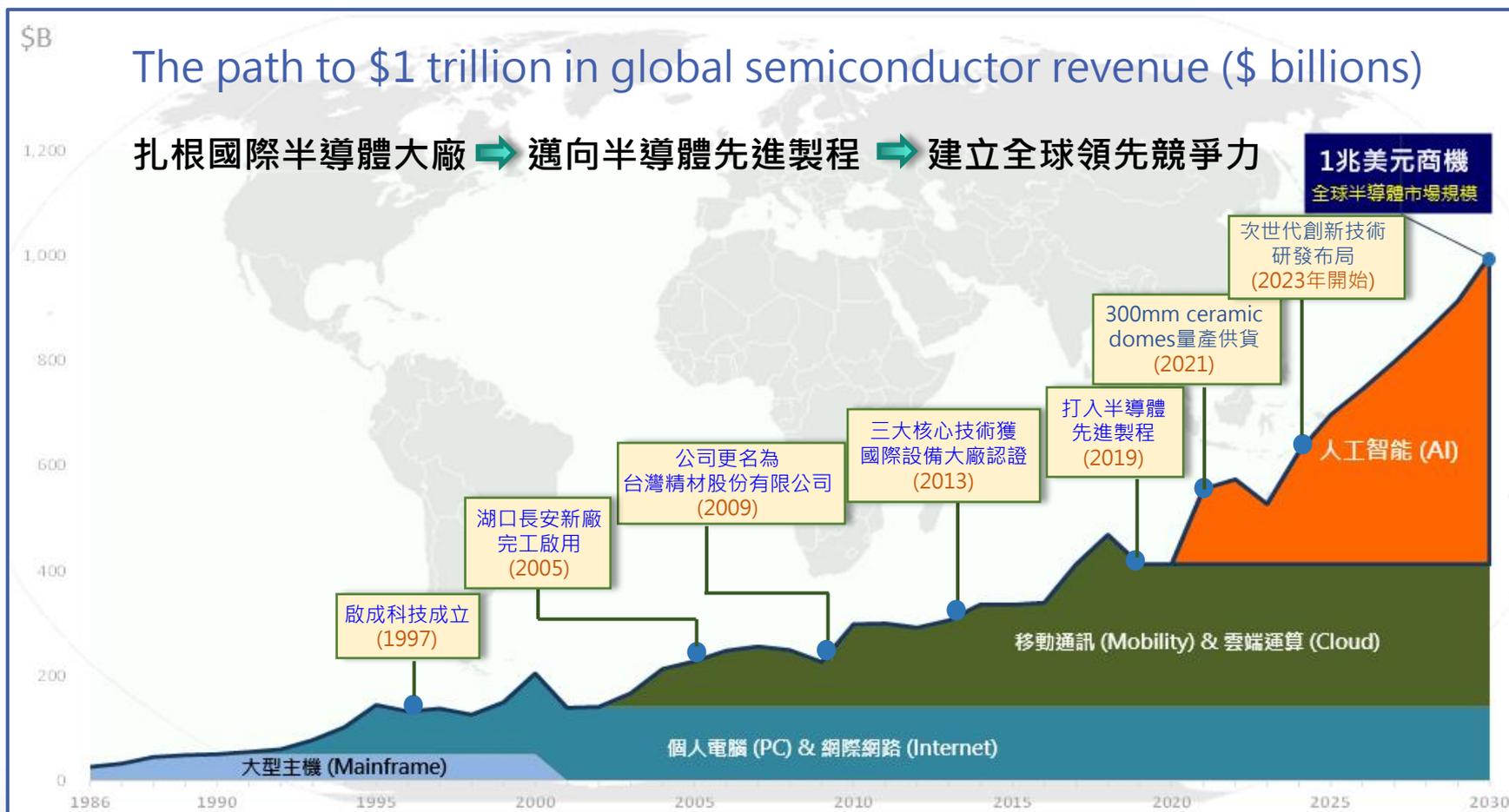
Source: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS), December 2024

2024全球半導體設備市場預期成長6.5%

- WFE (wafer fab equipment): to grow 5.4%
- Test (test equipment): to increase 13.8%
- A&P (assembly & packaging): to rebound by 22.6%

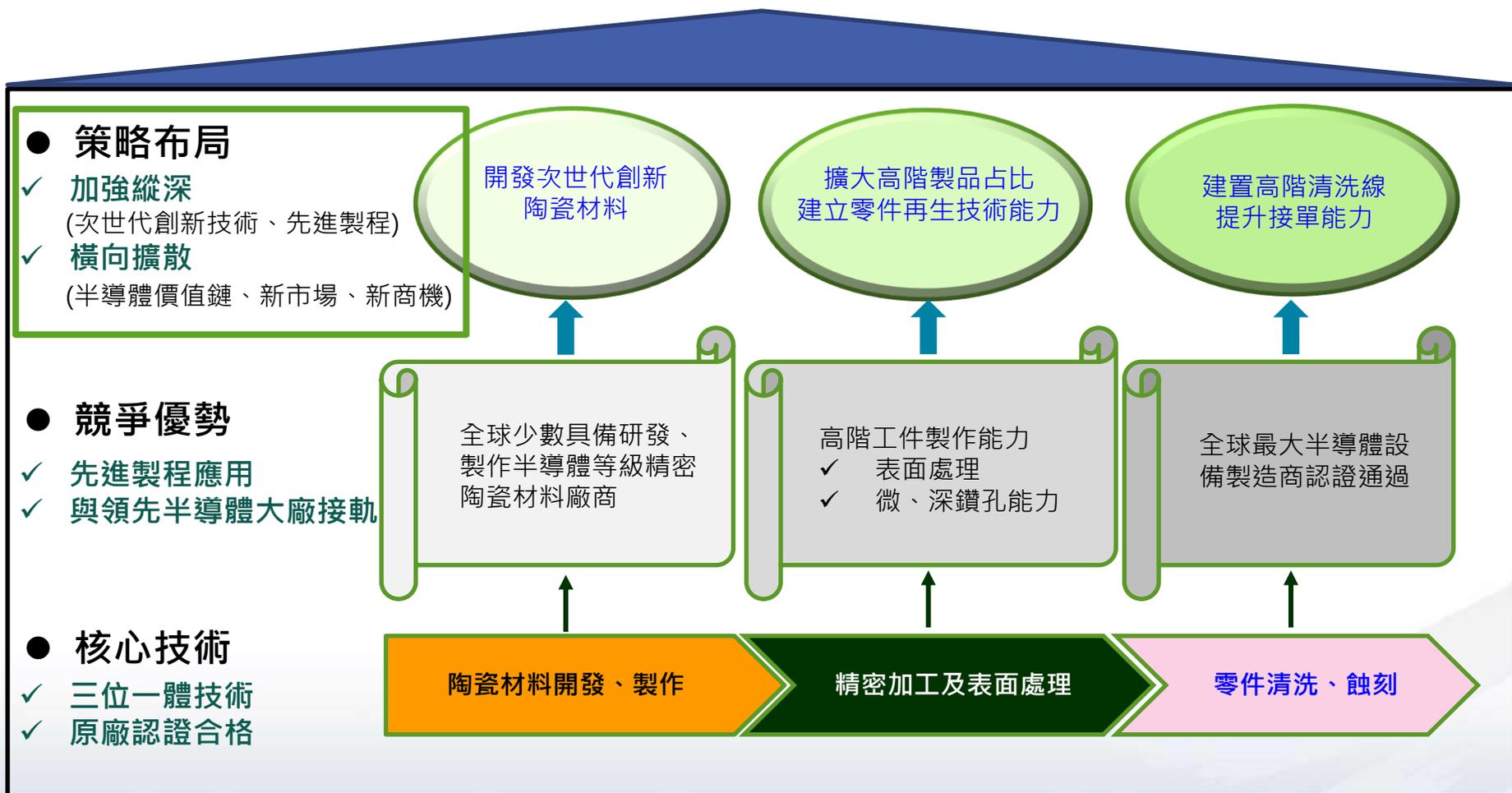
2025全球半導體設備市場預期成長7.1%

■ 全球半導體設備市場於2026年之前將呈現成長趨勢



Source: Forcera analysis and extrapolation based on data from World Semiconductor Trade Statistics

以現有核心技術為基礎，發揮競爭優勢，前瞻性策略布局，立足台灣，建立全球競爭力



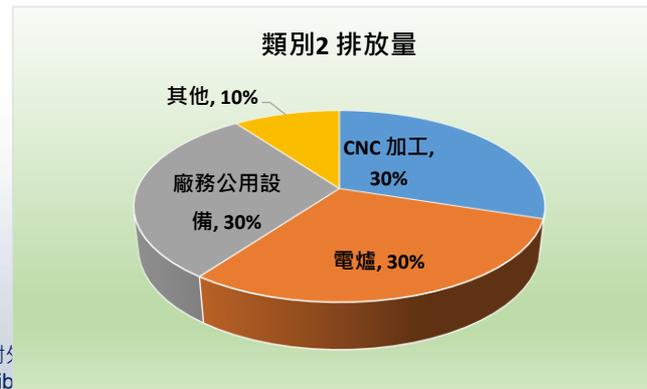
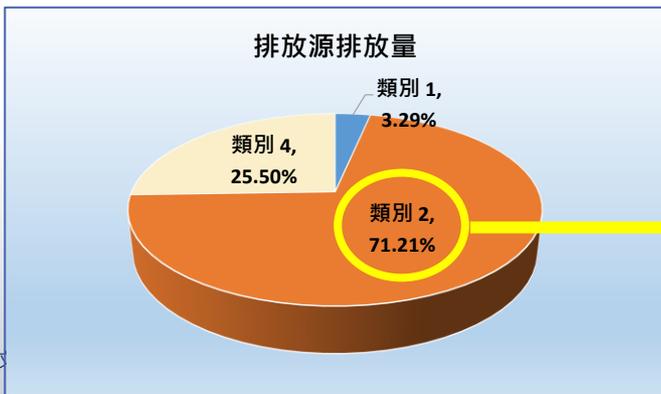
ESG 實績

- 率先於2022完成全廠區各類別排放源之排放量盤查 vs. 法規2026之要求
- 自2022年度起已建置碳排量盤查系統，以科學化、系統化、智慧化等彙整廠內各項排放源之數量進行統計、分析以做為公司推動淨零碳排政策目標

各類別排放源排放量

類別	類別1				類別2	類別4	總排放當量
	固定燃燒 <small>註1</small>	移動燃燒 <small>註2</small>	製程排放	逸散排放 <small>註3</small>	外購電力 <small>註4</small>	組織使用產品間接排放 <small>註5</small>	
排放當量 (公噸CO ₂ e)	151.4498				3,281.2065	1,175.0712	4,607.728
	65.5956	15.0899	0.0000	70.7643			
占比 (%)	3.29%				71.21%	25.50%	100%
	1.42%	0.33%	0.00%	1.54%			

註1: 發電機 註2: 公務車、貨車 註3: 冷氣機、冰箱、製冷飲水機、除濕機、冰水機、汽車空調、空壓機台冷乾機、化糞池、滅火器
 註4: 台電 註5: 購買原物料、廢棄物處置及清運

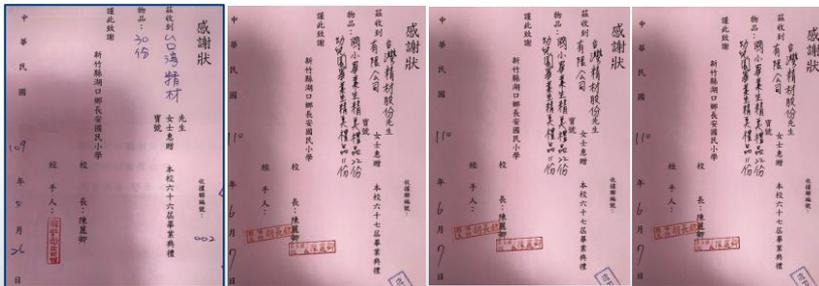


經書面許可，不得對外
 .Unauthorized distrib

● 敦親睦鄰、各項活動慶典捐贈



歷年感謝狀:



● 支援國際學生半導體暑期營活動

- 為國際社會培育更多的半導體人才
- 提高台灣精材在國際社會能見度

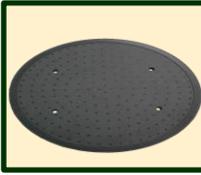
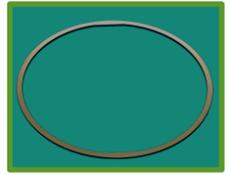
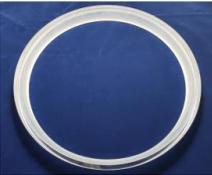


文件相關公開資訊須有本資料為台灣精材股份有限公司之專有財產。

This material is the property of the Forcera Materials Co.,LTD.Unauthorized distribution、copy、use or modification is prohibited.



Forcera Materials Co., Ltd.
台灣精材股份有限公司



Thank you